



勤凱科技股份有限公司 2025 法人說明會

2025. 11. 20

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



- 公司設立：2007年06月08日
- 資 本 額：NT\$ 3.22億
- 主要產品：先進封裝接著、散熱材料及
陶瓷元件導電材料設計製造及銷售
- 公司地址：

高雄市大發工業區大有三街32號

被動元件

電容、電感、電阻

- 銀漿、銀鈹漿、銅漿、鎳漿

新材料

- AI

IC\LED封裝

- 銀漿

觸控面板

電容式、電阻式

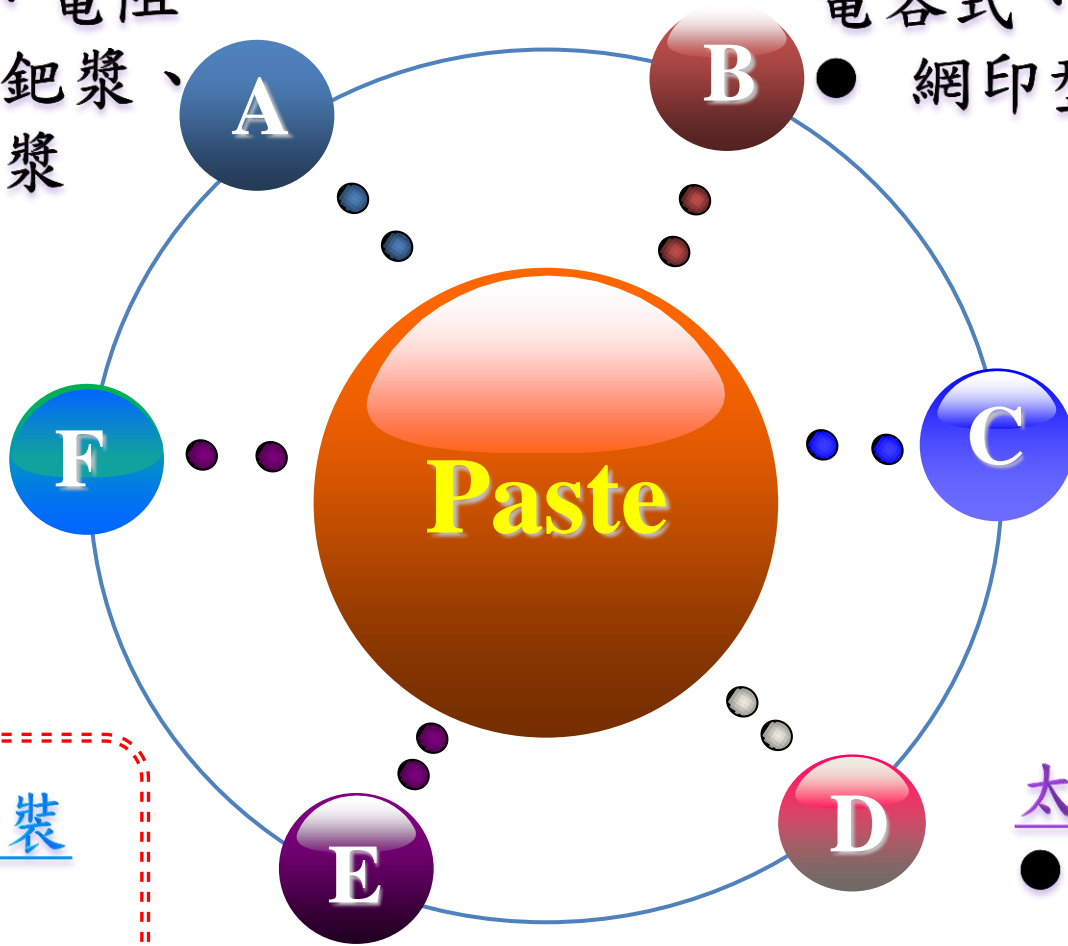
- 網印型、雷射型銀漿

薄膜開關

- 銀漿

太陽能

- 背銀



2025年《天下》兩千大營運績效50強

天下雜誌
CommonWealth
Magazine

2025年《天下》兩千大營運績效50強

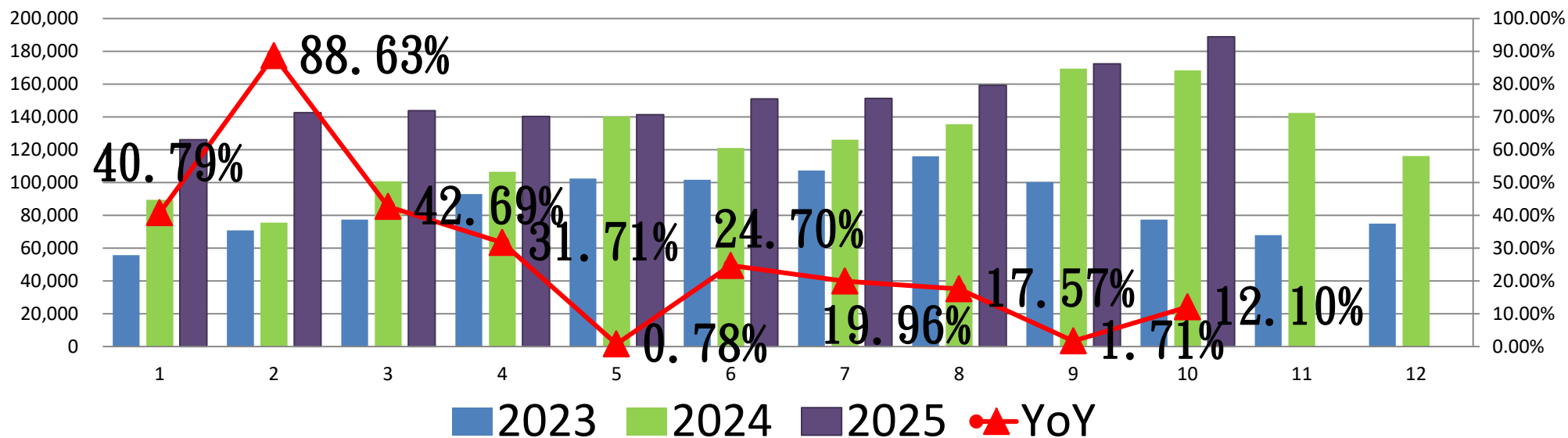
排名	公司名稱	'22年~'24年 營收成長率 (%)		'22年~'24年 稅後純益成長 率 (%)		2024年 股東權益報 酬率 (%)		2024年 營收成長 率 (%)		2024年 稅後純益成 長率 (%)		總分	主要產品
		得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分		
1	濟南大自然新材料	91.85	20	158.27	19	50.84	20	42.51	19	61.09	16	113	香菸濾嘴用醋酸纖維絲束
2	華城電機	61.45	19	126.15	19	48.85	20	45.35	19	66.32	17	112	配電及電力變壓器等設備
3	名軒開發	109.63	20	101.97	18	30.75	19	68.14	19	52.47	16	109	住宅或商業大樓興建、租售
4	世芯電子	94.59	20	87.48	18	16.33	11	70.49	19	93.86	19	106	特殊應用積體電路設計製造
4	富宇地產	336.52	20	702.84	20	27.95	18	84.33	20	168.56	20	106	住宅或商業大樓興建、租售
6	台光電子材料	29.02	18	37.41	13	27.29	18	55.89	19	74.53	18	105	銅箔基板、黏合片等
6	新潤興業	91.29	20	72.32	17	25.10	17	149.25	20	117.71	19	105	住宅及大樓興建、租售
8	昇益開發	145.76	20	152.32	19	33.16	19	124.26	20	130.12	19	103	住宅及大樓興建、租售
8	皇普建設	75.59	20	133.62	19	18.29	12	188.16	20	436.78	20	103	住宅或商業大樓興建、租售
40	潤德室內裝修設計工程	37.34	18	47.47	15	25.28	17	31.73	17	51.35	15	86	設計與裝修工程
43	中台資源科技	43.14	19	50.74	15	14.95	9	34.98	18	60.39	16	85	廢棄物資源化處理
43	勤創科技	26.80	17	43.71	14	20.54	14	42.78	19	62.39	17	85	被動元件導電漿
45	力麗科技	52.30	19	29.38	11	22.34	15	99.78	20	35.88	14	84	IoT應用平台暨解決方案
46	肯微科技	24.02	16	36.52	13	9.89	5	32.04	18	78.57	18	83	伺服器電源供應器
46	信鼎技術服務	12.82	11	26.79	10	43.13	20	17.52	14	52.95	16	83	廢棄物資源化處理

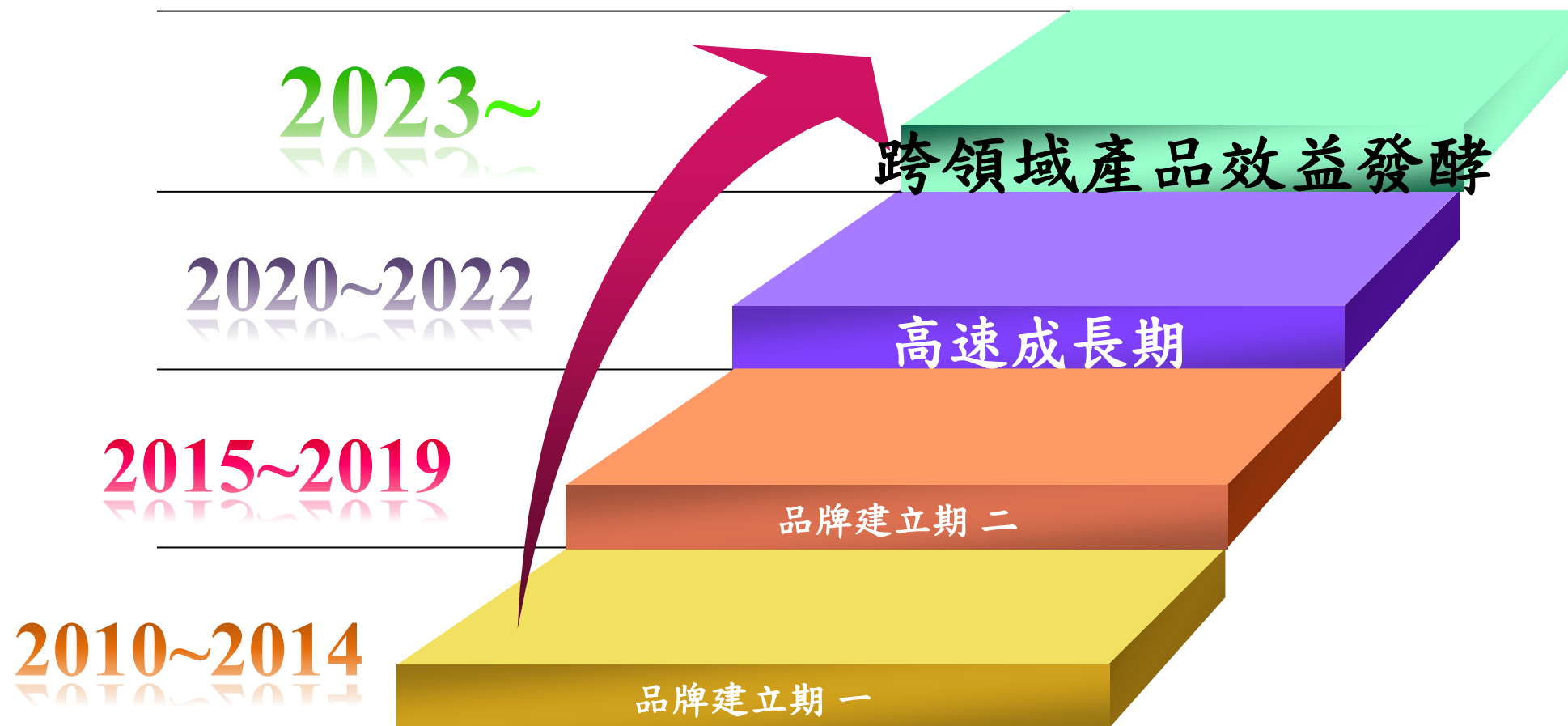


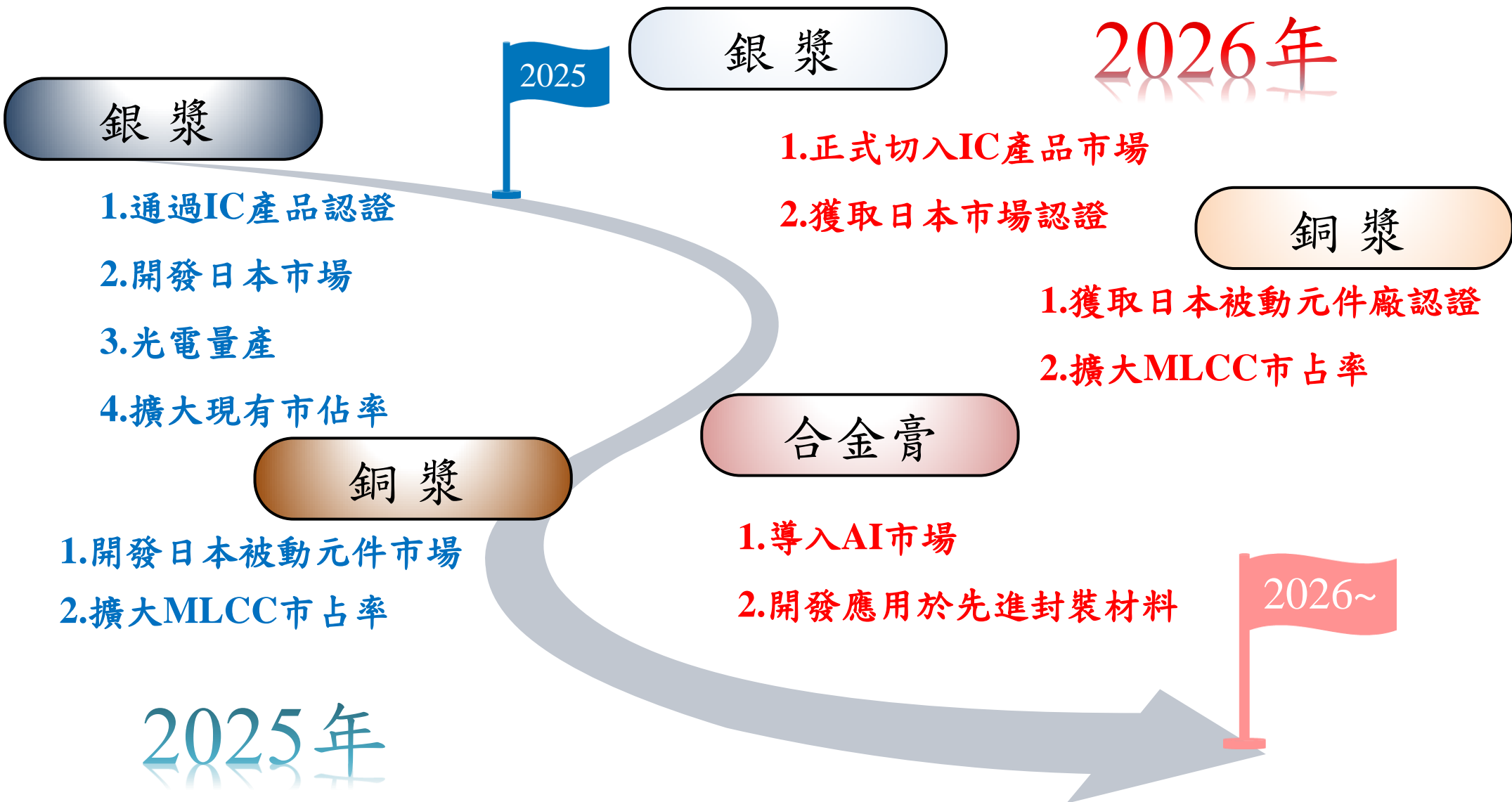
2025年營運績效50強調查方法：將過去3年（2022~2024）每年營收、獲利皆持續成長的製造業與服務業，依長期成長、單年表現及企業規模等6項指標評估企業的營運績效。符合上述條件的企業，分別在每項指標中，依數值高低分成20等份，再依據相對位置給予1到20分。最後，將6項指標的得分加總，以總分排名。名次相同者，依公司名稱筆劃排序。

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accumulated
2021	134,517	140,857	146,066	154,568	155,720	162,519	166,611	165,828	162,539	131,852	112,998	101,094	1,735,167
2022	100,068	80,781	102,422	103,193	100,299	100,052	78,029	54,894	45,927	47,703	53,678	61,045	928,090
2023	55,712	70,767	77,474	92,910	102,508	101,741	107,330	116,087	100,286	77,414	67,862	74,912	1,045,002
2024	89,533	75,599	100,786	106,535	140,287	121,125	126,057	135,482	169,400	168,439	142,406	116,230	1,491,879
2025	126,050	142,604	143,812	140,320	141,377	151,040	151,219	159,285	172,303	188,815			1,516,825
YoY	40.79%	88.63%	42.69%	31.71%	0.78%	24.70%	19.96%	17.57%	1.71%	12.10%			
MoM	8.45%	13.13%	0.85%	-2.43%	0.75%	6.83%	0.12%	5.33%	8.17%	9.58%			

2025 Monthly Revenue







展開**ESG**認證產品，促進市場降低碳排放汙染，與世界零污染接軌。

勤凱的**領先研發團隊與製造能力**以創造符合客戶需求

模擬客戶產品線及完整檢驗流程，並提供
最佳品質

領先製造技術能力

送樣後與客戶密集討論及完整測試

運用尖端研發能力，設計符合客戶產品

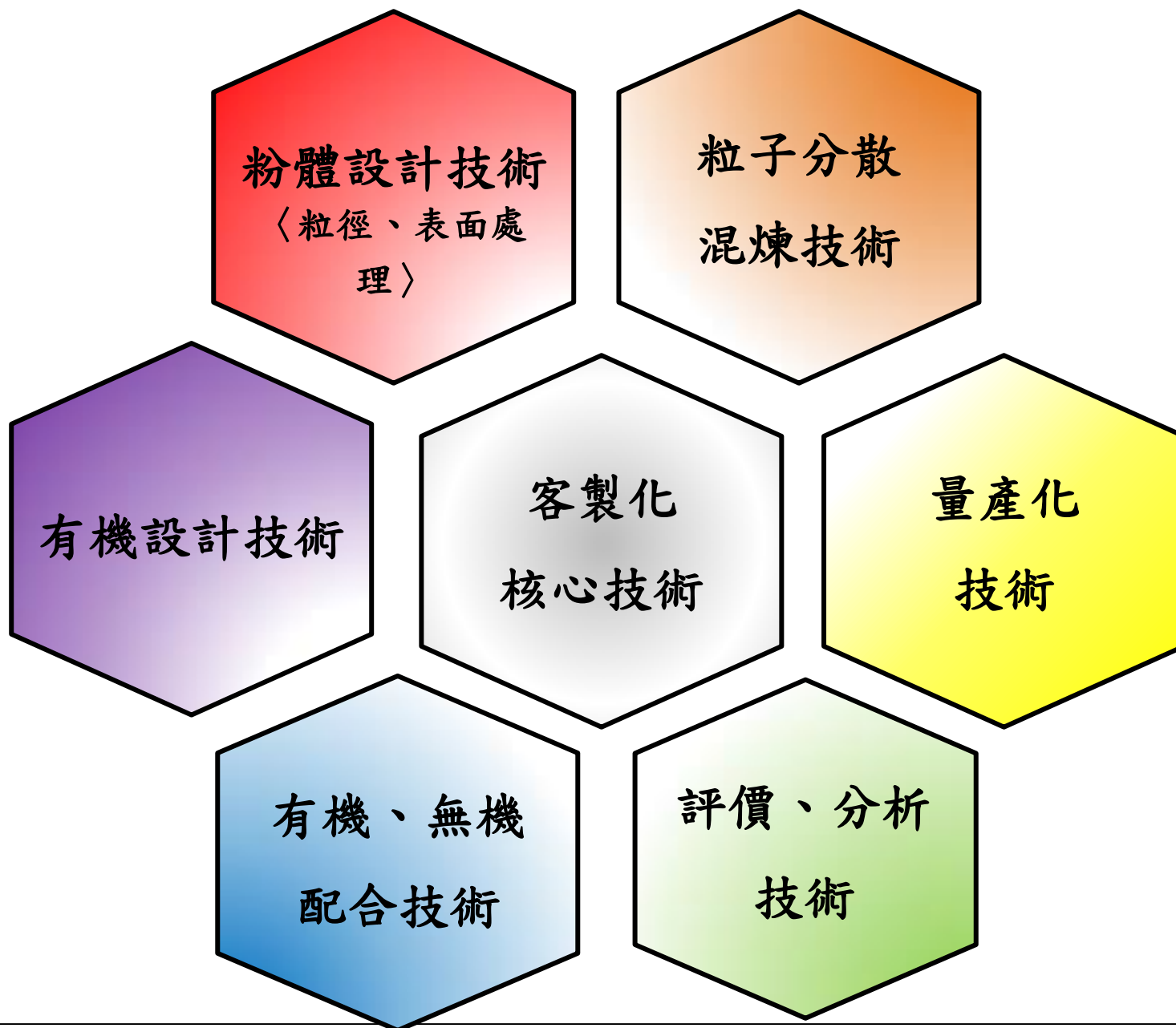
了解客戶

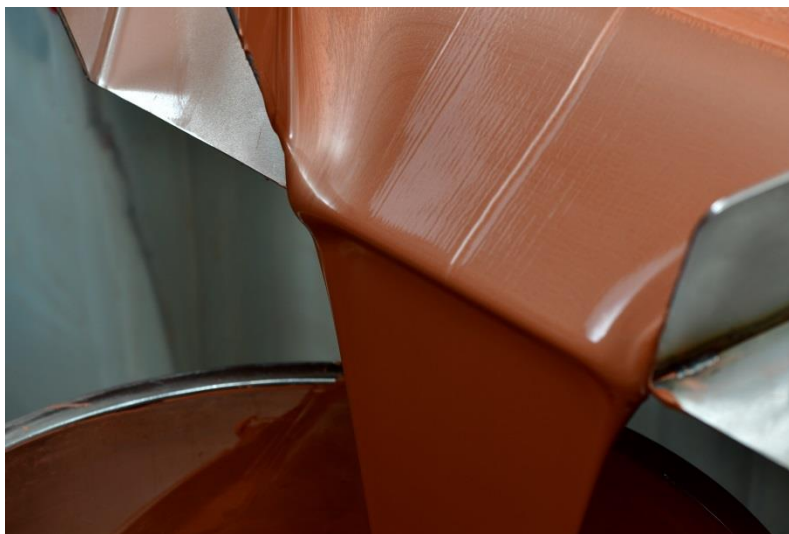


UP

勤凱位居**領先地位**，我們的配方研發及產品客製化能力
形成了**進入製造市場必須跨過的高門檻**

核 心 技 術





- TIM1散熱材料應用於先進封裝提供新散熱解決方案材料。

現行市售TIM1使用材料：

	熱傳導	現況TIM1材料問題
矽膠	8 W/m. K	模量低但熱傳不足
石墨片	20 W/m. K	需增加接著劑黏接
銅片	80 W/m. K	熱傳高但模量大

新TIM1材料技術指標

熱傳導：> 80W/m. K

模量：< 3GPa

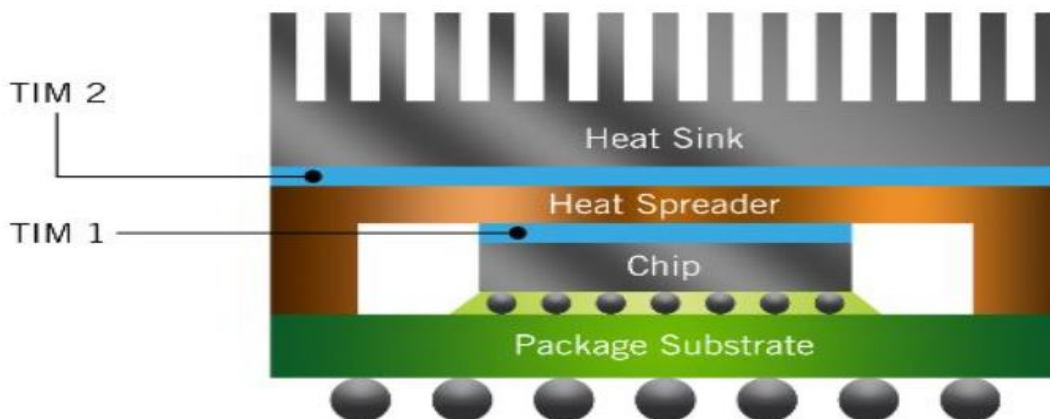
應用尺寸：65*65mm



Ample導入半燒結膠系統做改質：

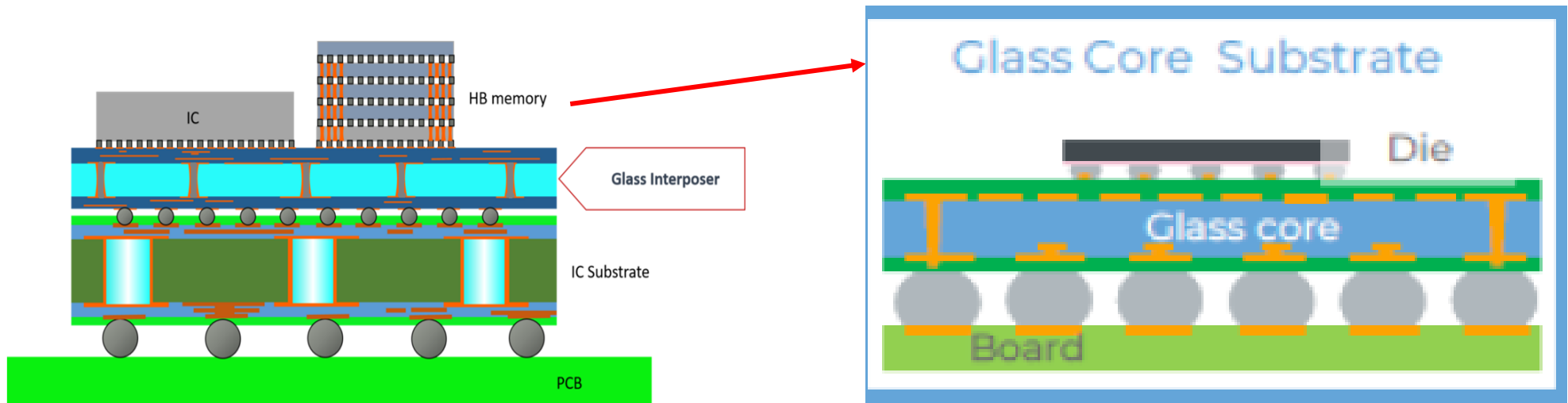
1. 高熱傳

2. 低模量



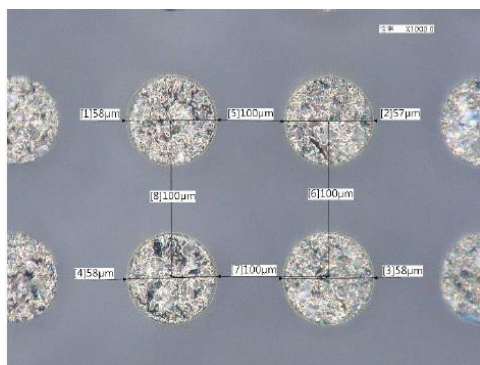
TGV(Through Glass Via，玻璃穿孔)

把原先使用於有機基板材料-替代成**玻璃**，而TGV (Through Glass Via) 技術就在**玻璃基板**上形成導電通道或孔洞，用來連接多層電路，使用玻璃中介板的優點包括**介電特性好、無翹曲問題、透明、機械穩定性高、熱膨脹係數(CTE)**等。

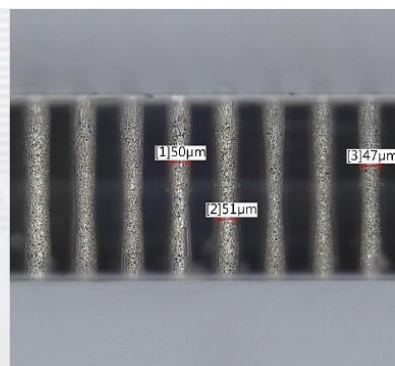


表面孔徑 : 60 μm
寬深比 : 1 : 8.3
(Aspect ratio)

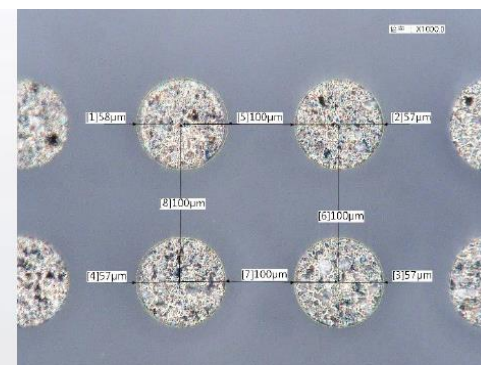
➤ 填孔性、玻璃附著性 Pass



Via $\Phi 60\mu\text{m}$ & filled Alloy Cu (Top)



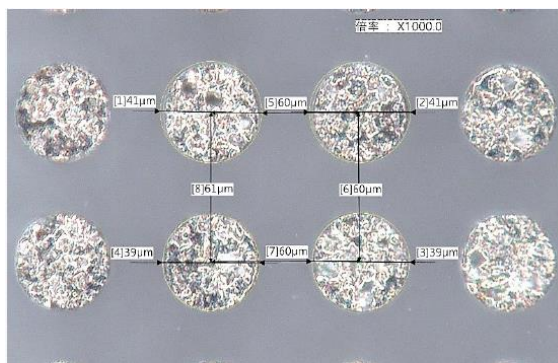
Via $\Phi 60\mu\text{m}$ & filled Alloy Cu (X-section)



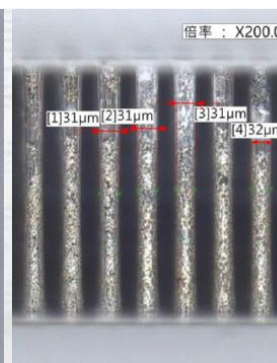
Via $\Phi 60\mu\text{m}$ & filled Alloy Cu (Bottom)

表面孔徑 : 40 μm
寬深比 : 1 : 12.5
(Aspect ratio)

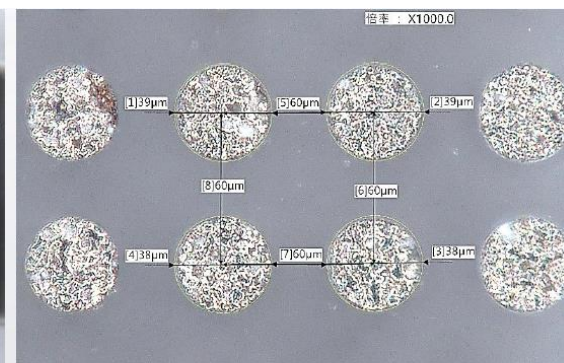
➤ 填孔性、玻璃附著性 Pass



Via $\Phi 40\mu\text{m}$ & filled Alloy Cu (Top)



Via $\Phi 40\mu\text{m}$ & filled Alloy Cu (X-section)



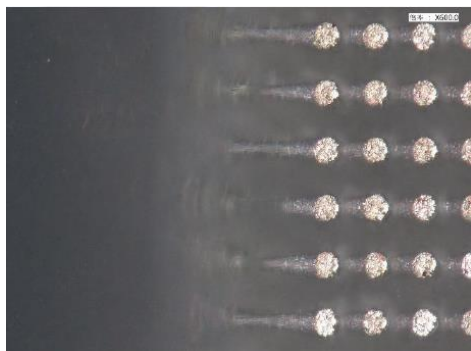
Via $\Phi 40\mu\text{m}$ & filled Alloy Cu (Bottom)

玻璃基板厚度	表面孔徑 (Avg.)	腰身孔徑 (Avg.)	寬深比 (Aspect ratio)	結果
470 um	30 um	18 um	1 : 15.7	玻璃附著、填孔性 Pass

填膏後表面 (TOP)



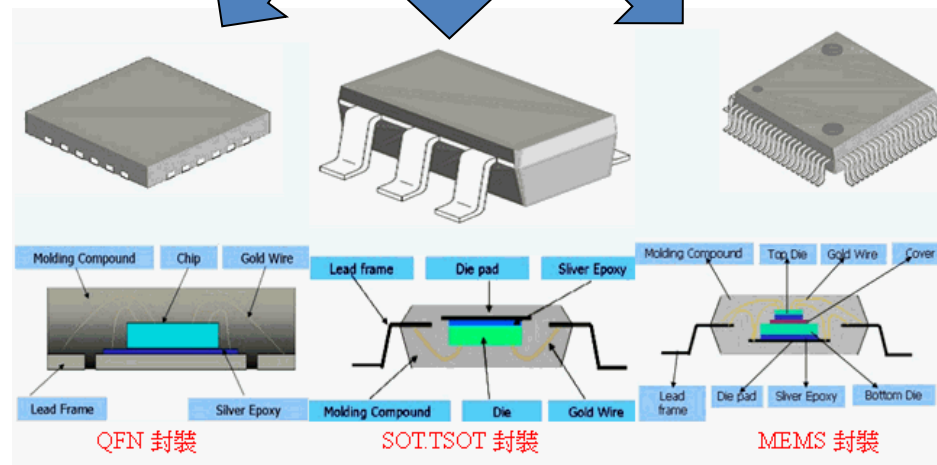
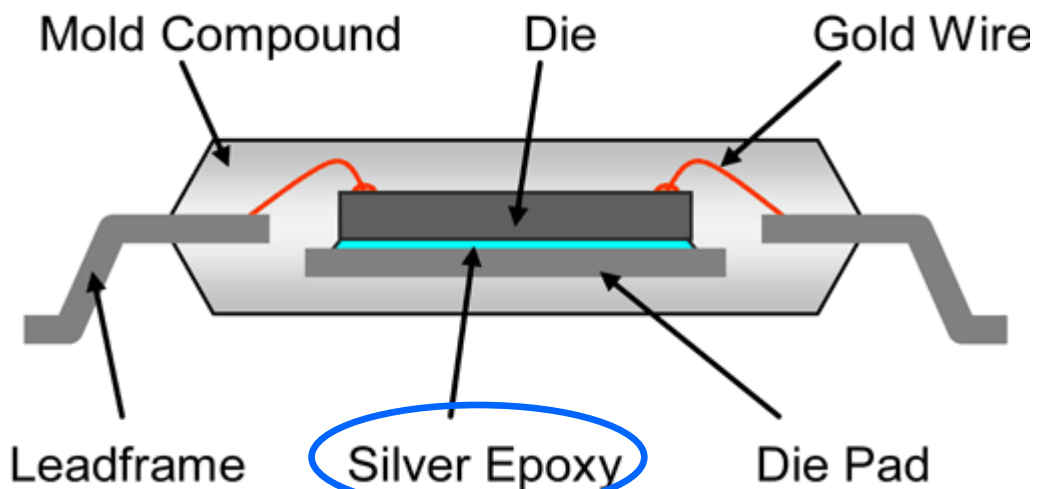
側向30度填孔狀況



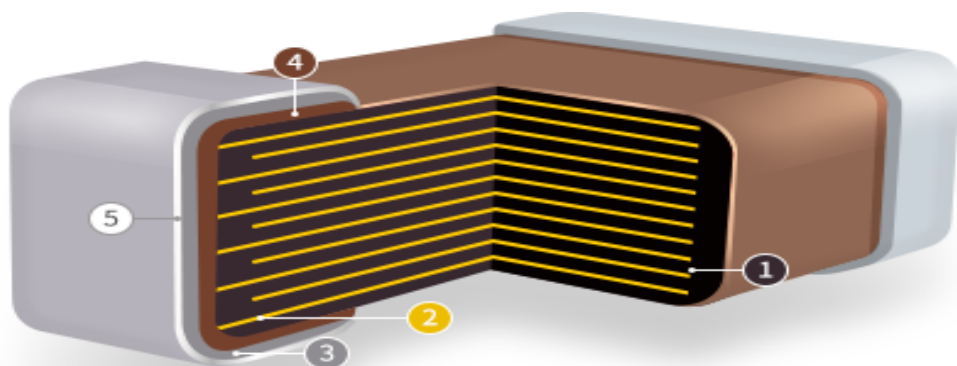
	TGV 填孔導電膏
優勢	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 對玻璃附著佳 ◆ 空隙率低 ◆ 可省略CMP製程 ◆ 寬深比(Aspect ratio)優於電鍍銅極限(1 : 10) ◆ 低熱膨脹係數(CTE) ◆ 高導熱性、優異體積電阻(5.0E-5 ~ 6.0E-6) ◆ 客製化(黏度/電性/TGV孔徑)



導線架 Die Bonding



MLCC 電容



- ① Ceramic body
- ② Electrode(Ni/Cu*)
- ③ Plating(Ni)
- ④ Termination (Cu or Cu+Metal Epoxy)
- ⑤ Plating(Sn)

* Internal Cu electrode is only applied to limited products.

晶片電阻



   				
星期五 14-11月-2025 15:42			Closes in 14 hrs. 19 mins	
▼ 貴金屬		 美元		每 千克
更新於		買盤	賣盤	變動
15:38	黃金	134004.31	134068.61	-73.95
15:38	白銀	1691.13	1694.99	12.54
15:38	鉑金	50894.63	51216.14	64.30
15:38	鈀金	45171.80	46457.83	-160.75
07:00	銻	253187.12	270870.03	0.00
▼ 基金屬				每 千克
更新於		買盤	賣盤	變動
15:34	銅	10.8900	10.8926	0.0474
▼ 原油*				

綜合損益表-2025Q3

NT\$ 千元								3Q2025	
	2021	2022	2023	2024	3Q2025	2Q2025	1Q2025	QoQ	YoY
營業收入	1,734,567	928,090	1,045,002	1,491,879	482,808	432,736	412,467	12%	12%
營業毛利	351,754	194,267	224,069	326,055	105,556	81,537	95,735	29%	25%
毛利率(%)	20%	21%	21%	22%	22%	19%	23%	16%	9%
營業費用	(107,357)	(89,559)	(95,247)	(104,018)	(29,492)	(23,671)	(28,497)	25%	17%
營業費用率(%)	-6%	-9%	-9%	-7%	-6%	-6%	-7%	0%	0%
營業淨利	244,397	104,708	128,822	222,037	76,064	57,866	67,238	31%	28%
營業淨利率(%)	14%	12%	12%	15%	16%	13%	16%	23%	14%
兌換利益淨額	7,266	12,872	4,808	19,391	11,700	(35,751)	5,262	-133%	-222%
其他營業外收支淨額	(3,088)	(1,163)	9,537	(3,633)	(456)	(1,177)	2,142	-61%	-86%
稅前淨利	248,575	116,417	143,167	237,795	87,308	20,938	74,642	317%	87%
所得稅費用	(47,450)	(24,059)	(26,443)	(48,028)	(17,024)	(5,999)	(13,965)	184%	79%
本期淨利	201,125	92,358	116,724	189,767	70,284	14,939	60,677	370%	89%
淨利率(%)	12%	10%	11%	13%	15%	4%	15%	275%	67%
每股盈餘(元)	6.70	3.08	3.90	6.30	2.22	0.50	2.01	344%	90%
折舊費用	21,097	24,873	23,682	23,271	5,724	5,567	5,553		
資本支出	24,937	12,419	13,020	12,489	4,892	2,586	2,232		

資產負債表

NT\$ 千元	2025/9/30	2024/12/31	2024/9/30
現金及約當現金	207,509	90,968	98,048
應收帳款淨額	690,481	665,654	602,283
存貨	312,180	358,060	290,953
其他流動資產	17,143	48,386	71,985
流動資產小計	1,227,313	1,163,068	1,063,269
不動產、廠房及設備	183,354	190,953	195,873
其他非流動資產	183,920	152,985	164,885
非流動資產小計	367,274	343,938	360,758
資產總計	1,594,587	1,507,006	1,424,027
流動負債	627,380	580,865	547,149
非流動負債	812	1,249	304
負債總計	628,192	582,114	547,453
普通股股本	322,183	301,127	321,127
其他權益	644,212	623,765	555,447
權益總計	966,395	924,892	876,574
每股淨值(元)	30.00	30.71	27.30
重要財務指標			
流動比率	196%	200%	194%
負債比率	39%	38%	38%

年度	2020	2021	2022	2023	2024
每股盈餘	4.74	6.70	3.08	3.90	6.30
配發股利	3.20	4.50	2.20	2.70	4.20
配息率	67.51%	67.16%	71.43%	69.23%	66.67%

連續12年配發股利！

凱
歌長奏盛名揚

勤
奮開拓質優良

世界級導電漿料供應商

